

2024年3月期
決算説明資料

上村工業株式会社

東京証券取引所スタンダード市場 証券コード：4966

2024年5月10日

2024年5月17日更新

【連結会計期間】

日本国内(2社)：4月～3月／海外(10社)：1月～12月

● 表面処理用資材事業

- 主力のパッケージ基板向けのめっき薬品は、前年度後半から続いているデータセンター向けサーバー市場における投資抑制とパソコンやスマートフォンの販売台数の落ち込みによる在庫調整の影響を受けて、売上高、セグメント利益ともに前連結会計年度を下回りました。

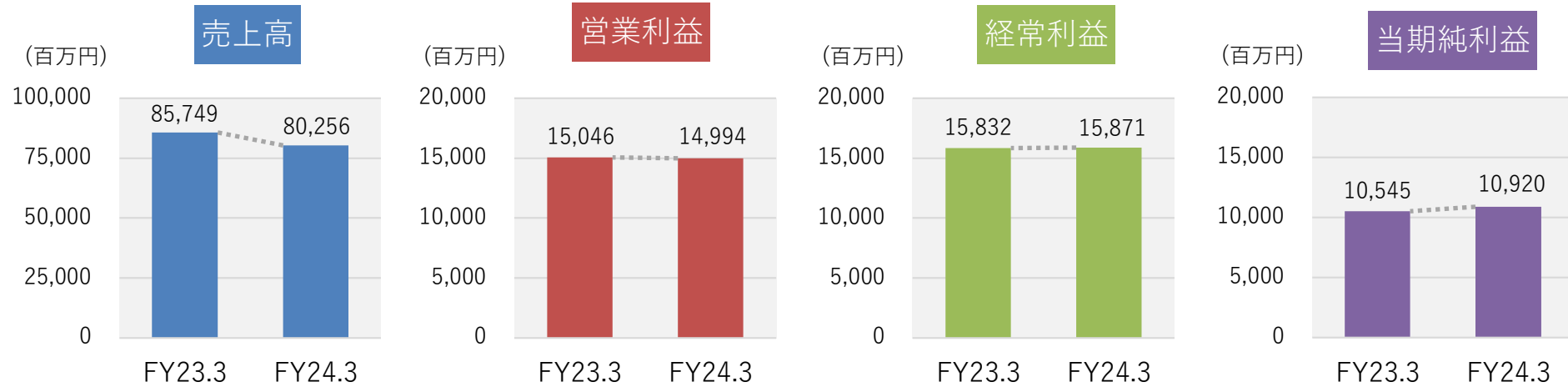
● 表面処理用機械事業

- 日本国内において半導体や電子部品向けのめっき用装置の販売が増加し、売上高、セグメント利益ともに前連結会計年度を上回りました。

● めっき加工事業

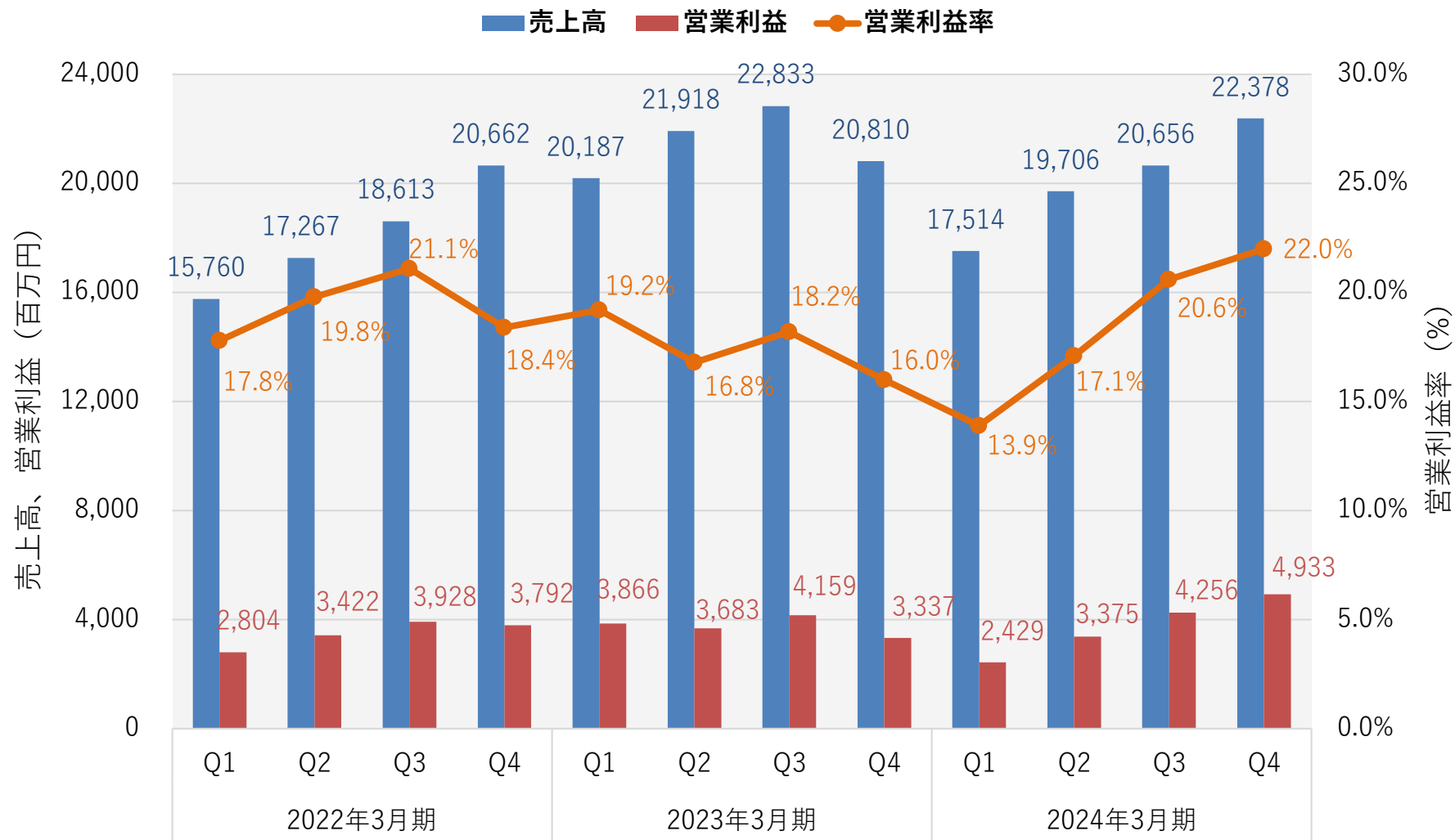
- タイやインドネシアにおける自動車産業は、急速な電気自動車の普及や塗装された部品の採用拡大により、プラスチックへのめっき加工の需要が低迷し、売上高、セグメント利益ともに前連結会計年度を下回りました。

2024年3月期 決算概要

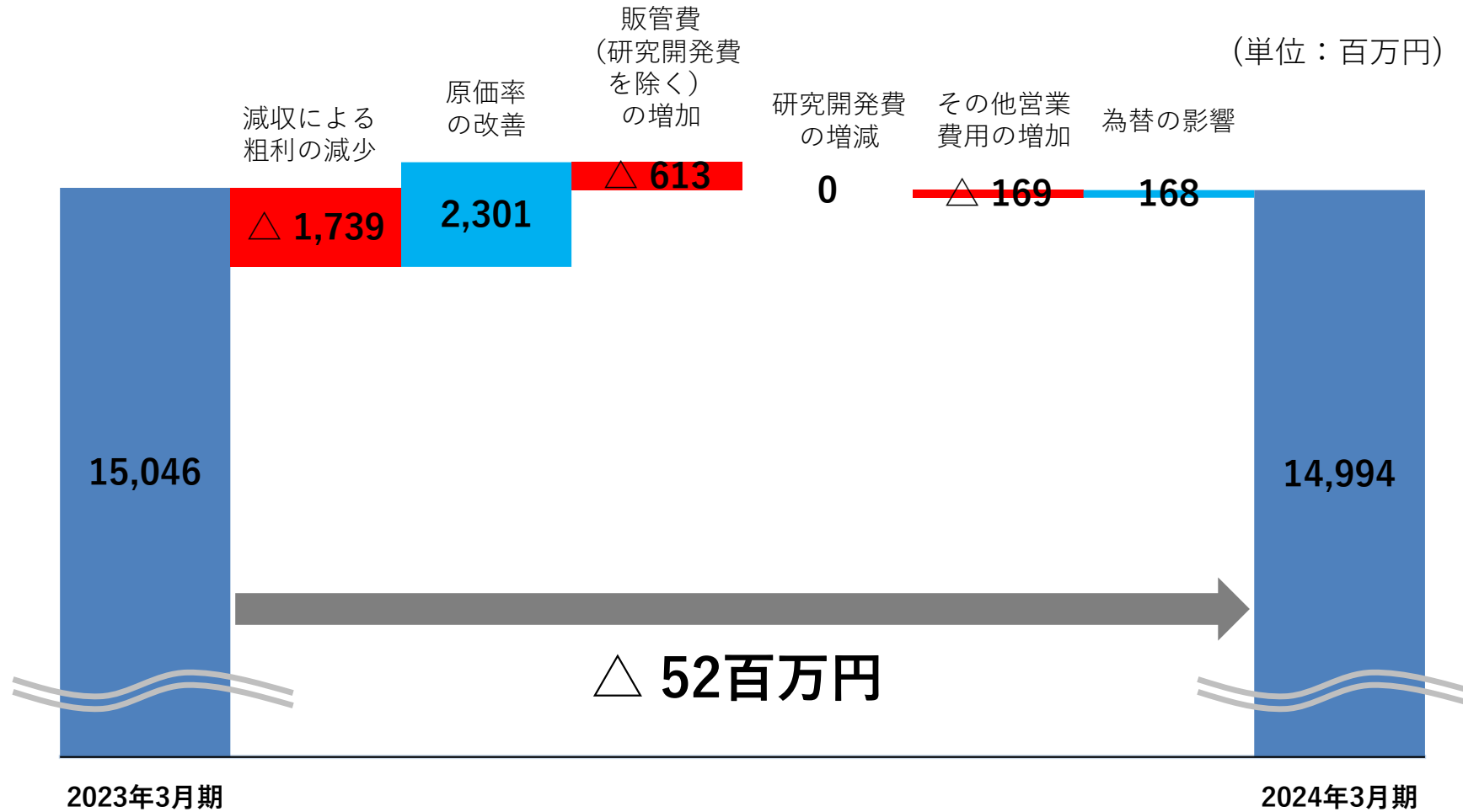


(単位：百万円)	2023年3月期 実績	2024年3月期 予想(2023.11.13修正)	2024年3月期 実績	前期比	予想比
売上高	85,749	78,180	80,256	△ 5,493 (△ 6.4%)	+ 2,076 (+ 2.7%)
営業利益	15,046	12,100	14,994	△ 52 (△ 0.3%)	+ 2,894 (+ 23.9%)
経常利益	15,832	12,930	15,871	+ 39 (+ 0.2%)	+ 2,941 (+ 22.7%)
当期純利益	10,545	8,790	10,920	+ 375 (+ 3.6%)	+ 2,130 (+ 24.2%)
為替：米ドル	131.62円	141.12円	140.67円	9.05円安	0.45円高

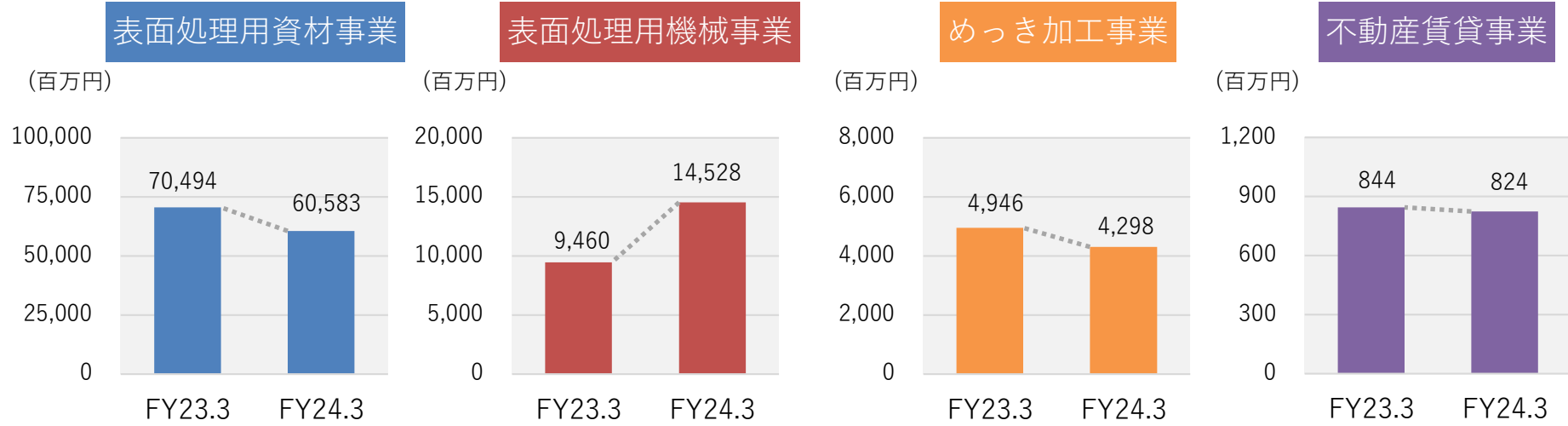
四半期毎の業績推移



営業利益の増減要因



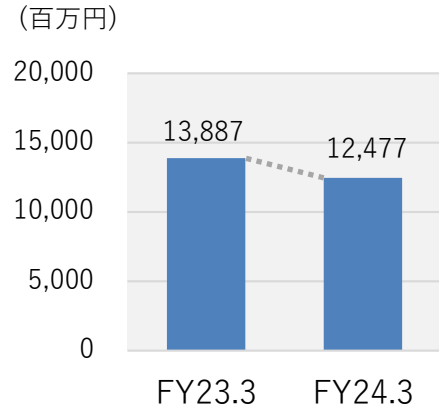
事業セグメント別売上高



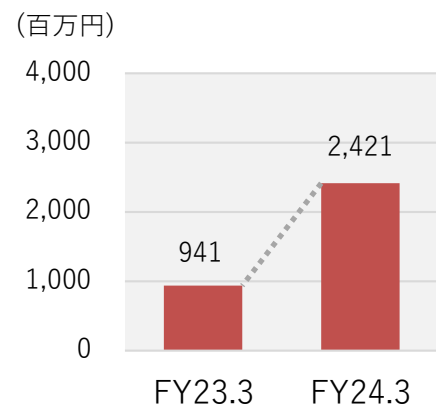
(単位：百万円)	2023年3月期 実績	2024年3月期 実績	増減額	増減率
表面処理用資材	70,494	60,583	△ 9,911	△ 14.1%
表面処理用機械	9,460	14,528	+ 5,068	+ 53.6%
めっき加工	4,946	4,298	△ 648	△ 13.1%
不動産賃貸	844	824	△ 19	△ 2.4%

事業セグメント別営業利益

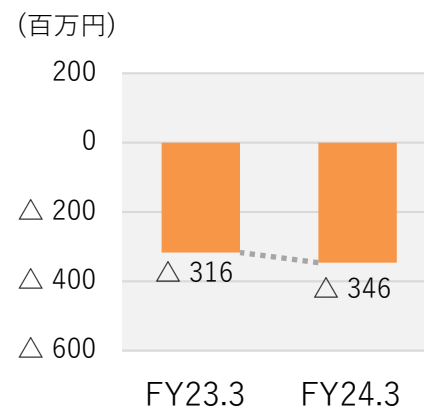
表面処理用資材事業



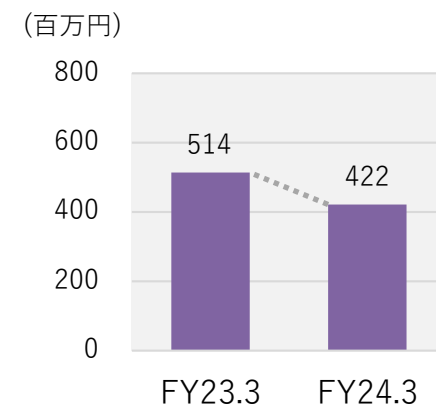
表面処理用機械事業



めっき加工事業

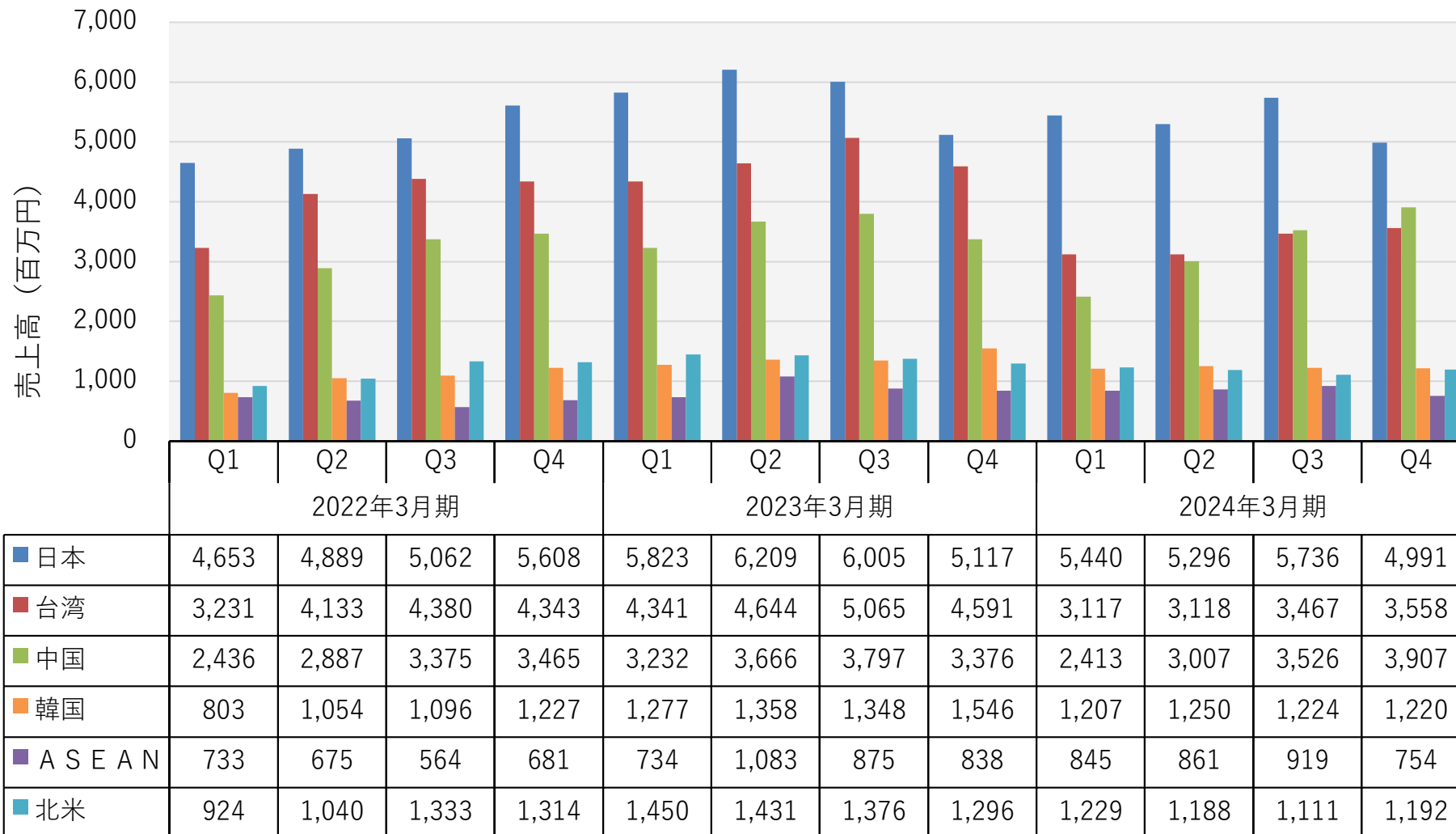


不動産賃貸事業

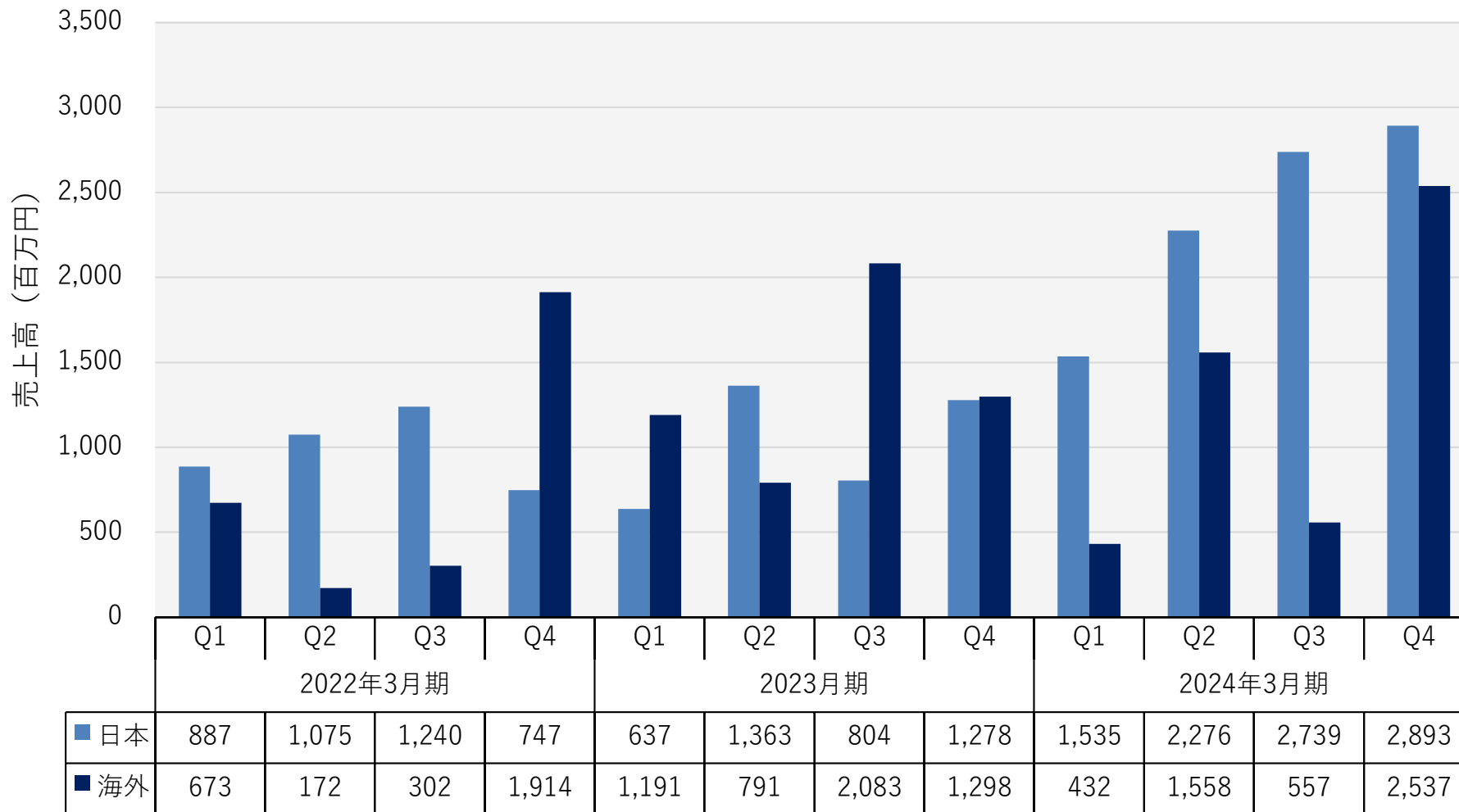


(単位：百万円)	2023年3月期 実績	2024年3月期 実績	増減額	増減率
表面処理用資材	13,887	12,477	△ 1,410	△ 10.2%
表面処理用機械	941	2,421	+ 1,479	+ 157.1%
めっき加工	△ 316	△ 346	△ 30	-
不動産賃貸	514	422	△ 92	△ 17.9%

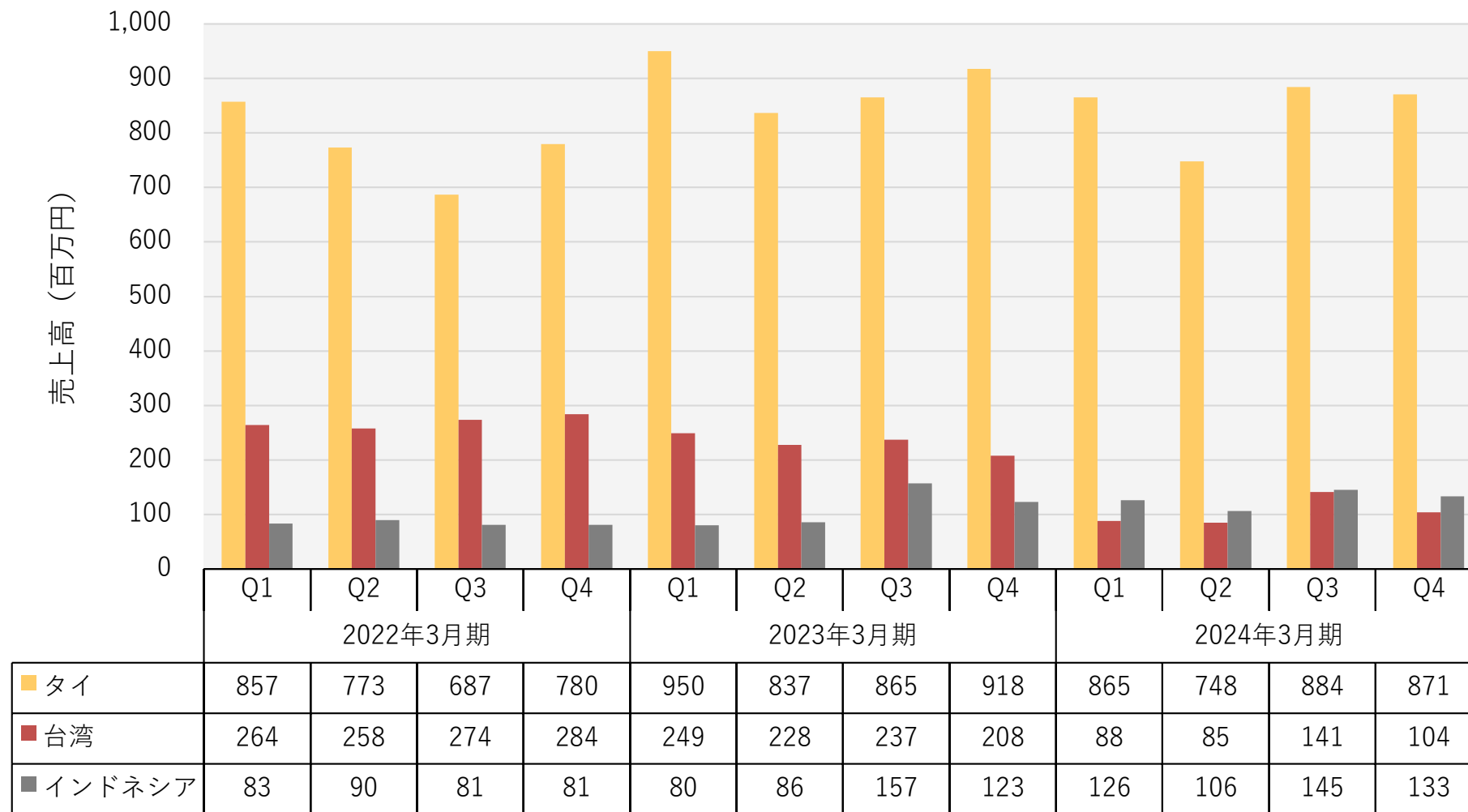
表面处理用資材事業 売上高推移



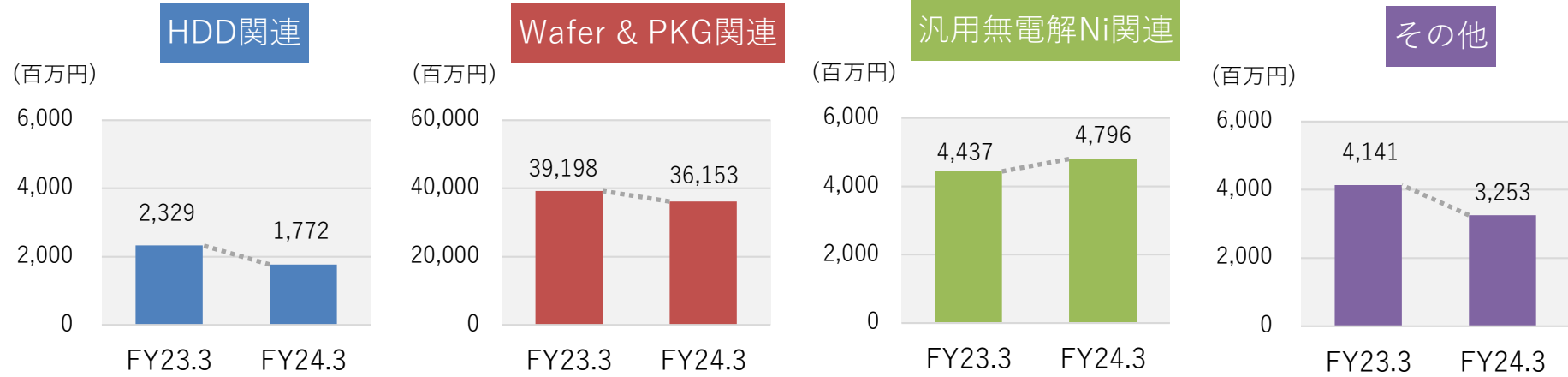
表面处理用機械事業 売上高推移



めっき加工事業 売上高推移



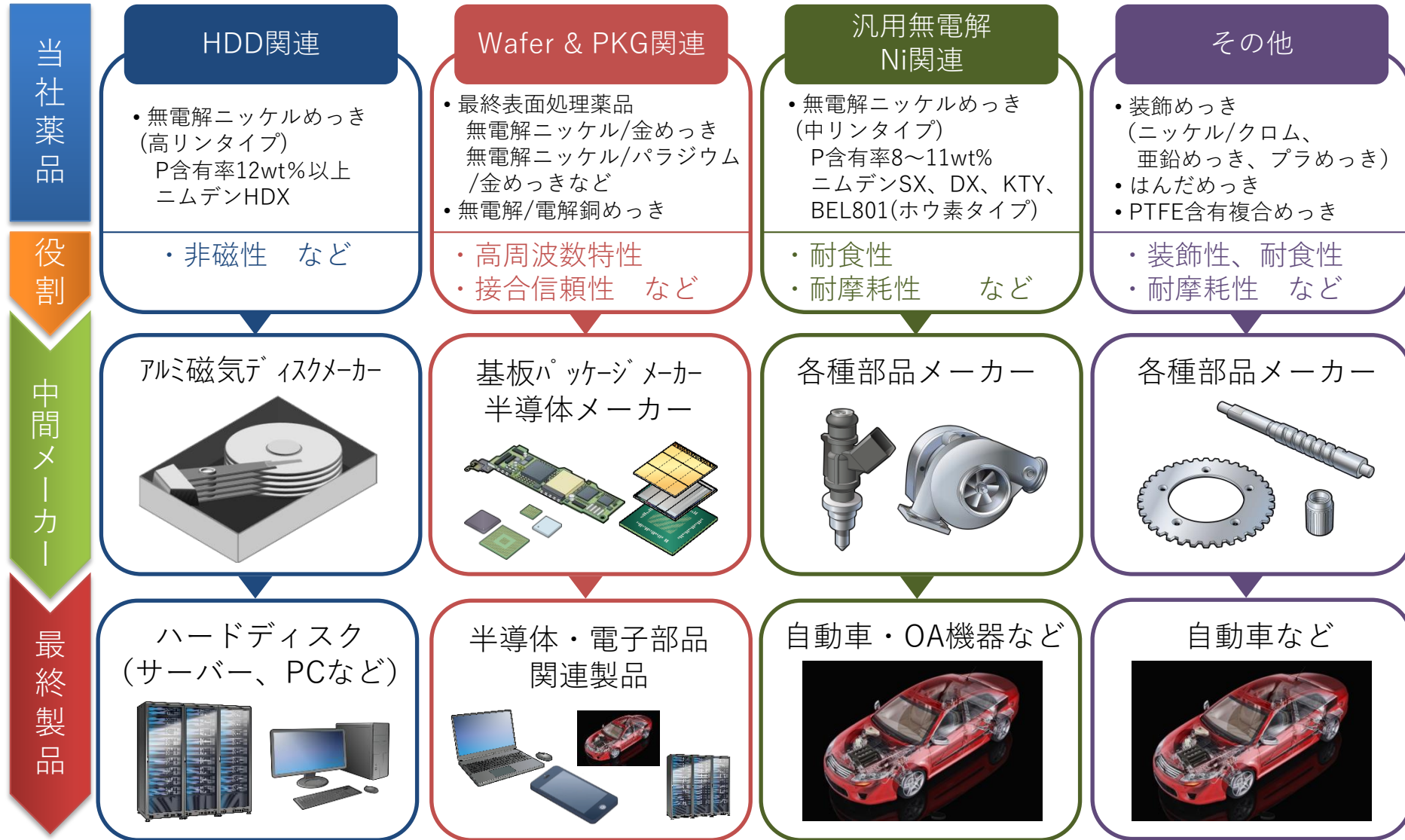
薬品カテゴリー別売上高



(単位：百万円)	2023年3月期実績		2024年3月期実績		増減額	増減率
		構成比		構成比		
HDD関連	2,329	4.6%	1,772	3.9%	△ 557	△ 23.9%
Wafer & PKG関連	39,198	78.2%	36,153	78.6%	△ 3,045	△ 7.8%
汎用無電解Ni関連	4,437	8.9%	4,796	10.4%	+ 358	+ 8.1%
薬品その他	4,141	8.3%	3,253	7.1%	△ 888	△ 21.4%
合計	50,107	100.0%	45,975	100.0%	△ 4,132	△ 8.2%

薬品の売上高は、表面処理用資材事業に含まれます。薬品には研磨剤、工業薬品、金属等は含んでおりません。※内部売上高含む

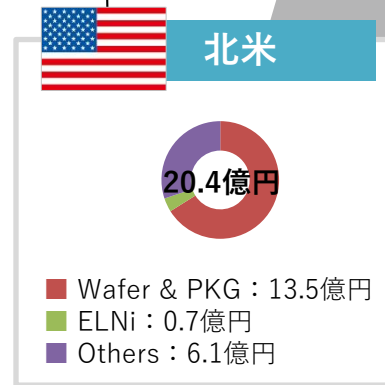
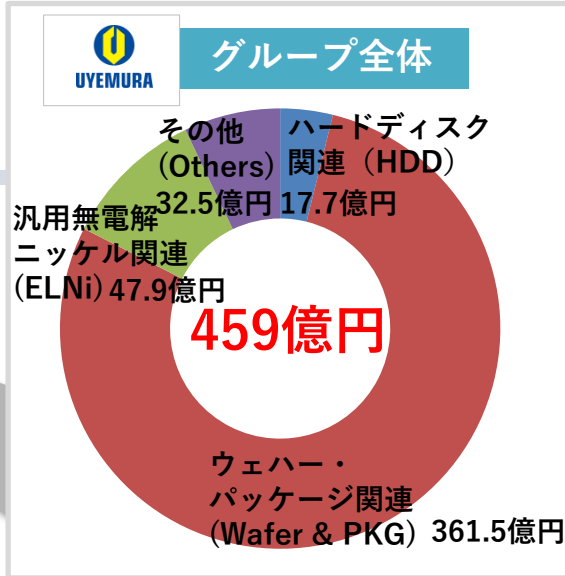
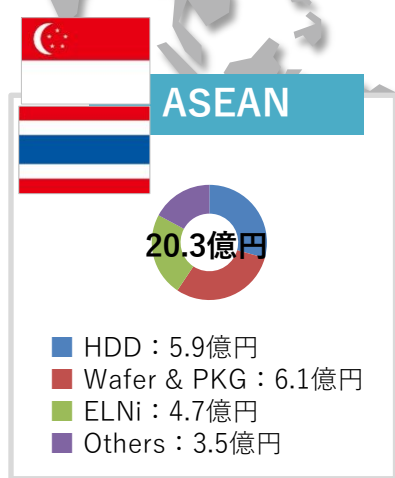
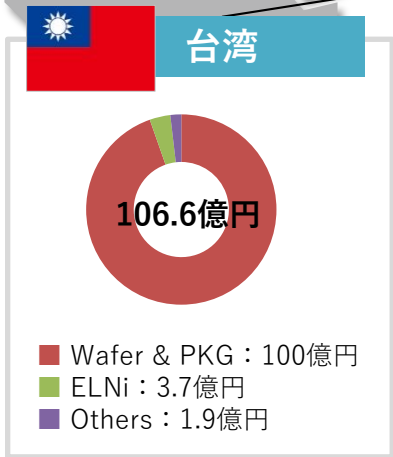
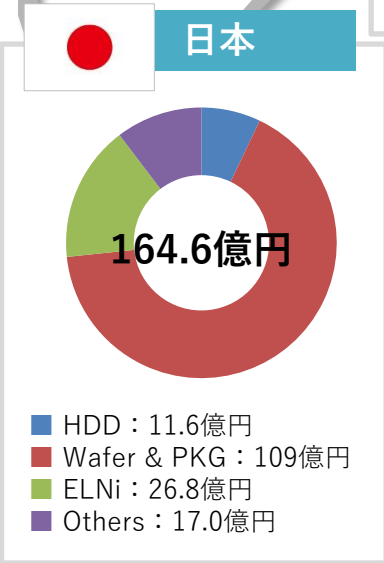
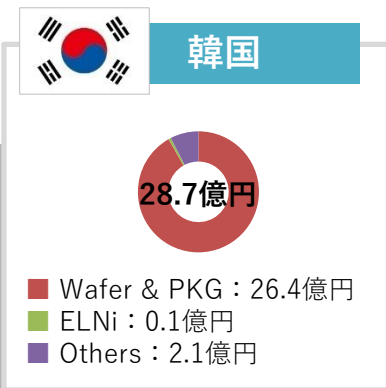
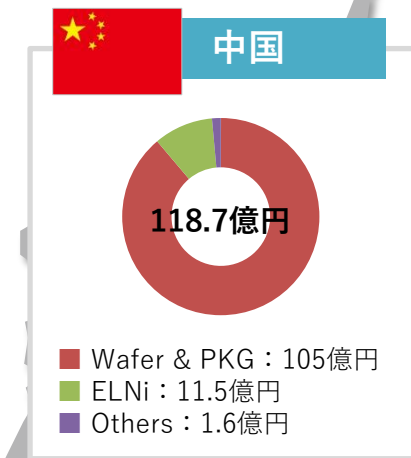
薬品ビジネス 最終製品までの流れ



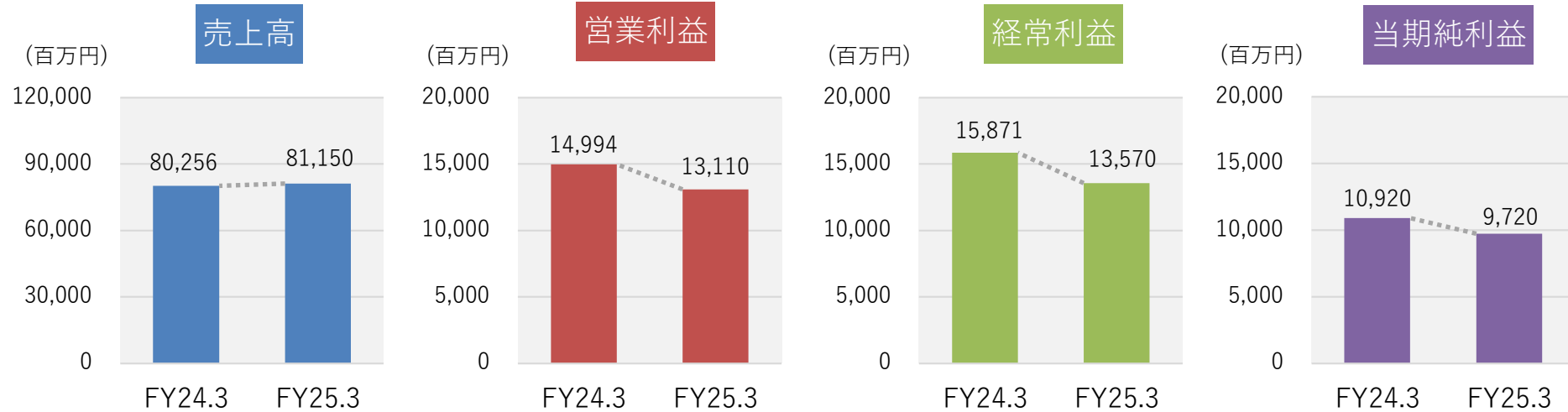
地域別薬品売上高

2024年3月期実績

※内部売上高含む



2025年3月期 通期業績予想



(単位：百万円)	2024年3月期 実績	2025年3月期 予想	増減額	増減率
売上高	80,256	81,150	+ 894	+ 1.1%
営業利益	14,994	13,110	△ 1,884	△ 12.6%
経常利益	15,871	13,570	△ 2,301	△ 14.5%
当期純利益	10,920	9,720	△ 1,200	△ 11.0%
為替：米ドル	140.67円	151.41円	10.74円安	

2025年3月期 通期業績予想

● 事業セグメント別売上高・営業利益予想

(単位：百万円)	売上高				営業利益			
	2024年3月期実績	2025年3月期予想	増減額	増減率	2024年3月期実績	2025年3月期予想	増減額	増減率
表面処理用資材	60,583	66,415	+5,831	+9.6%	12,477	12,489	+11	+0.1%
表面処理用機械	14,528	9,237	△5,291	△36.4%	2,421	283	△2,138	△88.3%
めっき加工	4,298	4,687	+389	+9.1%	△346	17	+363	-
不動産賃貸	824	797	△26	△3.3%	422	311	△110	△26.2%

● 薬品カテゴリー別売上高予想

(単位：百万円)	2024年3月期実績	2025年3月期予想	増減額	増減率
HDD関連	1,772	2,720	+947	+53.5%
Wafer & PKG関連	36,153	38,610	+2,456	+6.8%
汎用無電解Ni関連	4,796	4,810	+13	+0.3%
薬品その他	3,253	4,010	+756	+23.3%
合計	45,975	50,150	+4,174	+9.1%

<参考> 為替感応度

2025年3月期想定レート：151.41円(JPY/USD)

円安に1円振れると通期で

- ・ 売上：約350百万円増
- ・ 営業利益：約50百万円増

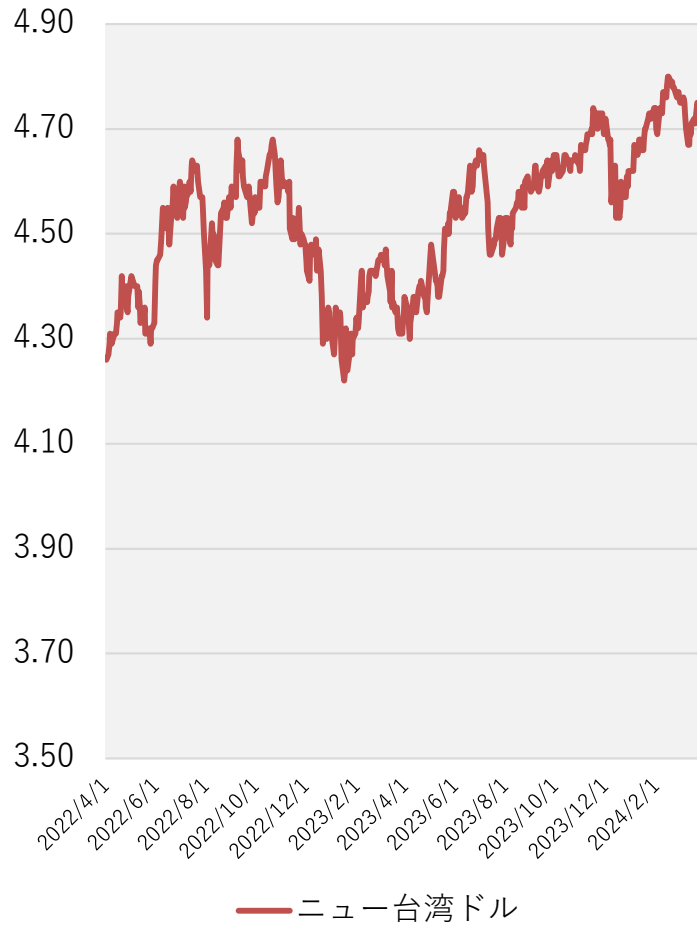
円高に1円振れると通期で

- ・ 売上：約350百万円減
- ・ 営業利益：約50百万円減

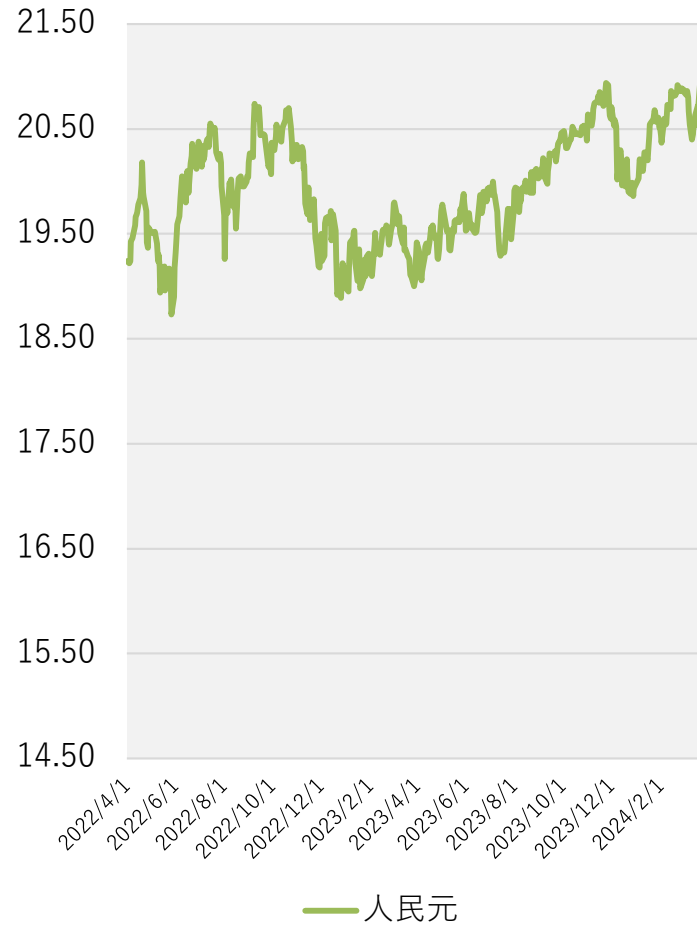
※米ドル以外の通貨も連動して動くことを想定しています。

為替レート推移

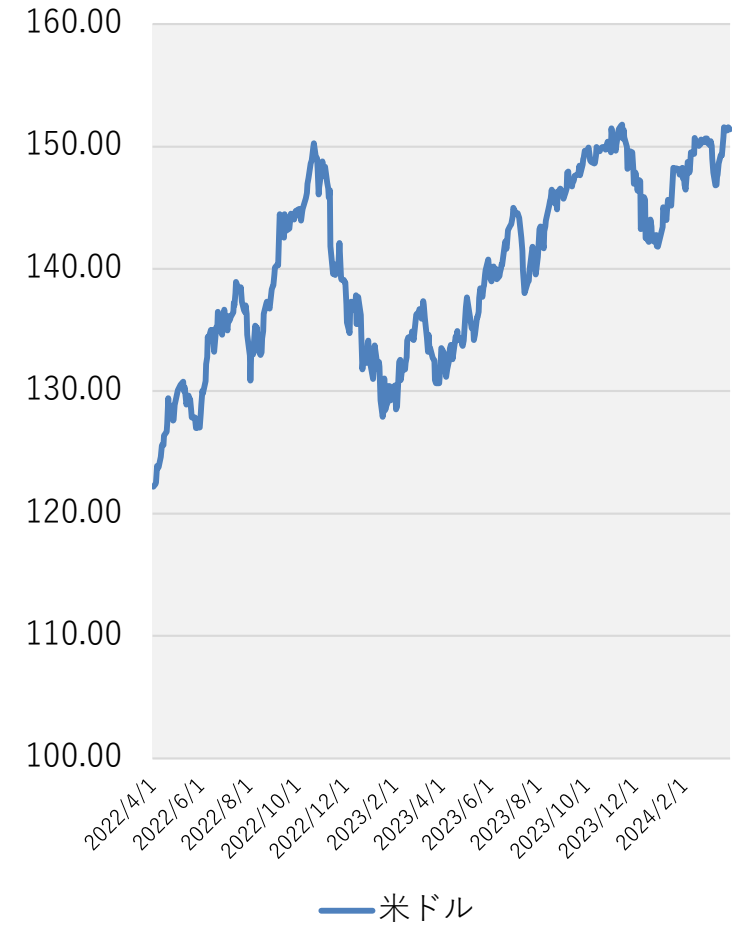
ニュー台湾ドル



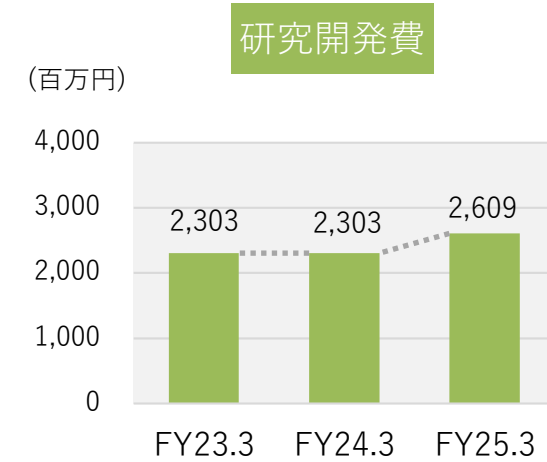
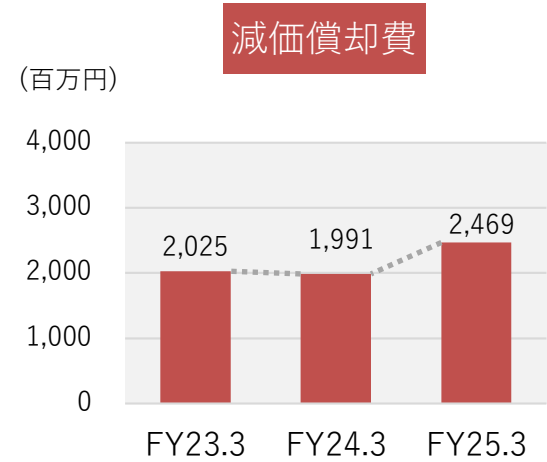
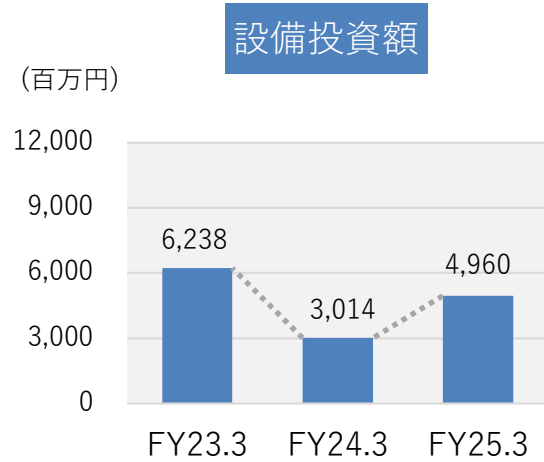
人民元



米ドル



設備投資/減価償却/研究開発費



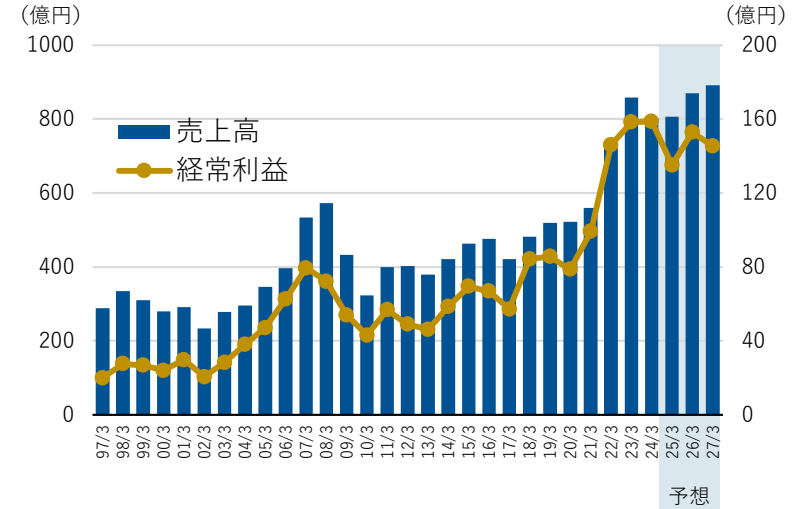
(単位：百万円)	2023年3月期 実績	2024年3月期 実績	2025年3月期 予想
設備投資額	6,238	3,014	4,960
減価償却費	2,025	1,991	2,469
研究開発費	2,303	2,303	2,609

引き続き開発投資、人材投資、設備投資を進め、競争力のある強い会社を目指す

3か年業績目標

	2024年3月期 (実績)	2027年3月期 (計画)
売上高	802 億円	891 億円
経常利益	158 億円	145 億円

株式上場以降の業績推移



2025年3月期-2027年3月期累計 投資計画

成長投資	200 億円	<ul style="list-style-type: none"> 超細線回路導電体形成技術強化 新素材への表面処理技術強化 環境対応型製品強化 クリーンルーム対応薬品供給体制強化
改善投資	40 億円	<ul style="list-style-type: none"> 製造品質の効率化 開発解析能力の強化 自然災害対応 環境規制への対応整備
内部留保	100 億円	<ul style="list-style-type: none"> M&A、想定外の事態や自然災害に備えた内部留保の確保

安定的な経営基盤の確保と株主資本利益率の向上を基本方針とした資本政策に取り組んでいます

資本政策における当社のKPI

1株当たり配当金
200円以上
を維持

ROE
10%以上
を維持

- 配当の下限值設定による安定した配当の実現
- 企業価値向上につながる研究開発設備の充実や半導体分野への投資の拡充
- 将来の成長が見込まれる分野や地域への投資、新たな技術取得、M&A、想定外の事態や自然災害に備えた内部留保の確保

背景・現状課題

当社では、安定的な経営基盤の確保と株主資本利益率の向上を資本政策の基本方針としております。株主の皆様への利益還元につきましては、安定的な配当の継続を業績に応じて行うことが必要と考えております。

2023年3月31日に東京証券取引所から公表された「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」に基づく要請を受け、改めて現状分析及び将来予測に基づいた検討を行いました。

当社では、2021年5月14日に開示した前中期経営計画における資本政策の目標値ROE 8.5%、中長期的に10%に対して、2022年3月期から2024年3月期のROEの実績は、13.1%→12.9%→12.3%と、目標を上回る水準で推移しました。

一方で、内部留保の積み上げで自己資本が増加しており、今後の事業・投資計画等を考慮しても、ROE等の資本収益性を示す指標は徐々に悪化していくことが想定されます。

対応方針・目標

当社は、企業価値の持続的な向上を目指すためには、財務健全性や資本効率、利益還元のバランスを考慮しながら資金配分することが重要であると考えております。具体的には、コーポレート・ガバナンス体制の充実や資本効率向上による株主還元を経営の重要課題の一つと位置付けるとともに、財務体質の強化や将来の成長が見込まれる分野や地域、必要であればM&Aや新たな技術取得に向けた機動的な投資をするため、また、想定外の事態や自然災害に備えるため、内部留保の確保にも努めております。

このように、当社は、継続・安定した開発投資、人材投資、設備投資を実施し、業績を上げ続けることができる強い魅力ある会社になるよう努めつつ、その時々々の経済状況、当社の財務状況等を総合的に勘案した上で、配当の下限値設定による安定した配当を業績に応じて実施する方針としております。

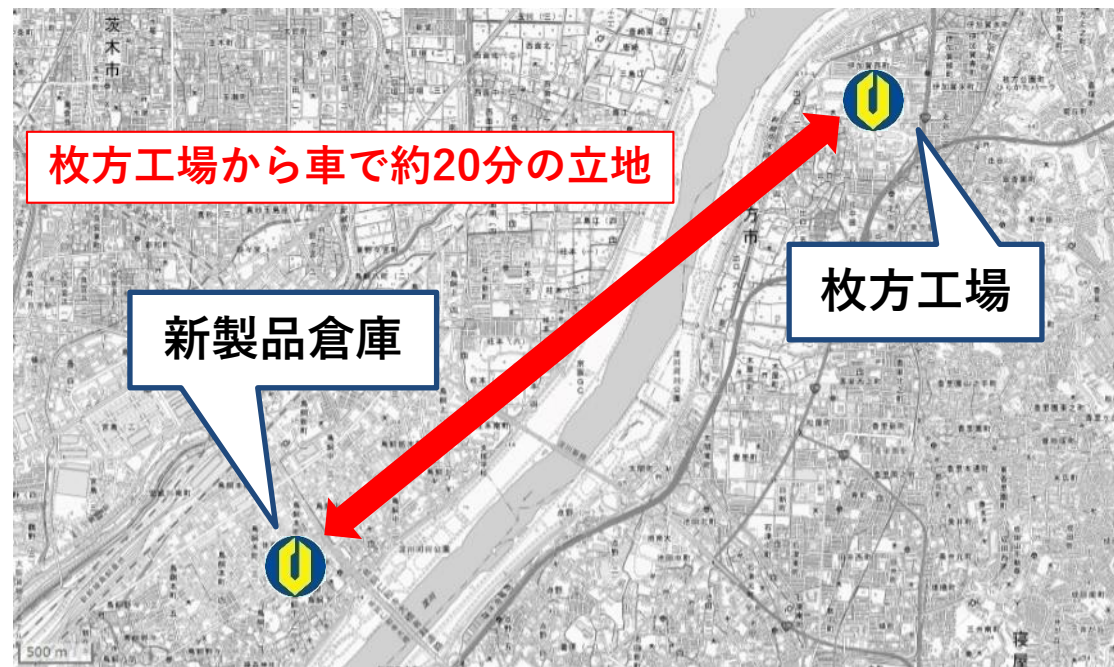
具体的には、1株当たり配当金は200円以上を維持し、ROEは10%以上の維持を目指してまいります。

さらに継続して資本コストを上回る資本収益性を達し、利益率の更なる向上に加え、事業規模やリスクに見合った自己資本のコントロールなど持続的な成長を果たすための抜本的な取り組みについて検討してまいります。

<トピックス> 新製品倉庫（大阪府摂津市） 建設計画



- ・所在地：大阪府摂津市鳥飼本町3丁目
- ・面積：約7,677m²
- ・投資予定額：約2,792百万円（設計・施工）
- ・自動ラック倉庫、出荷管理システム完備
- ・2026年6月末 倉庫建屋完成予定
（2027年2月～ 本稼働開始予定）



新製品倉庫のコンセプト



<トピックス> 上海技術センター開設



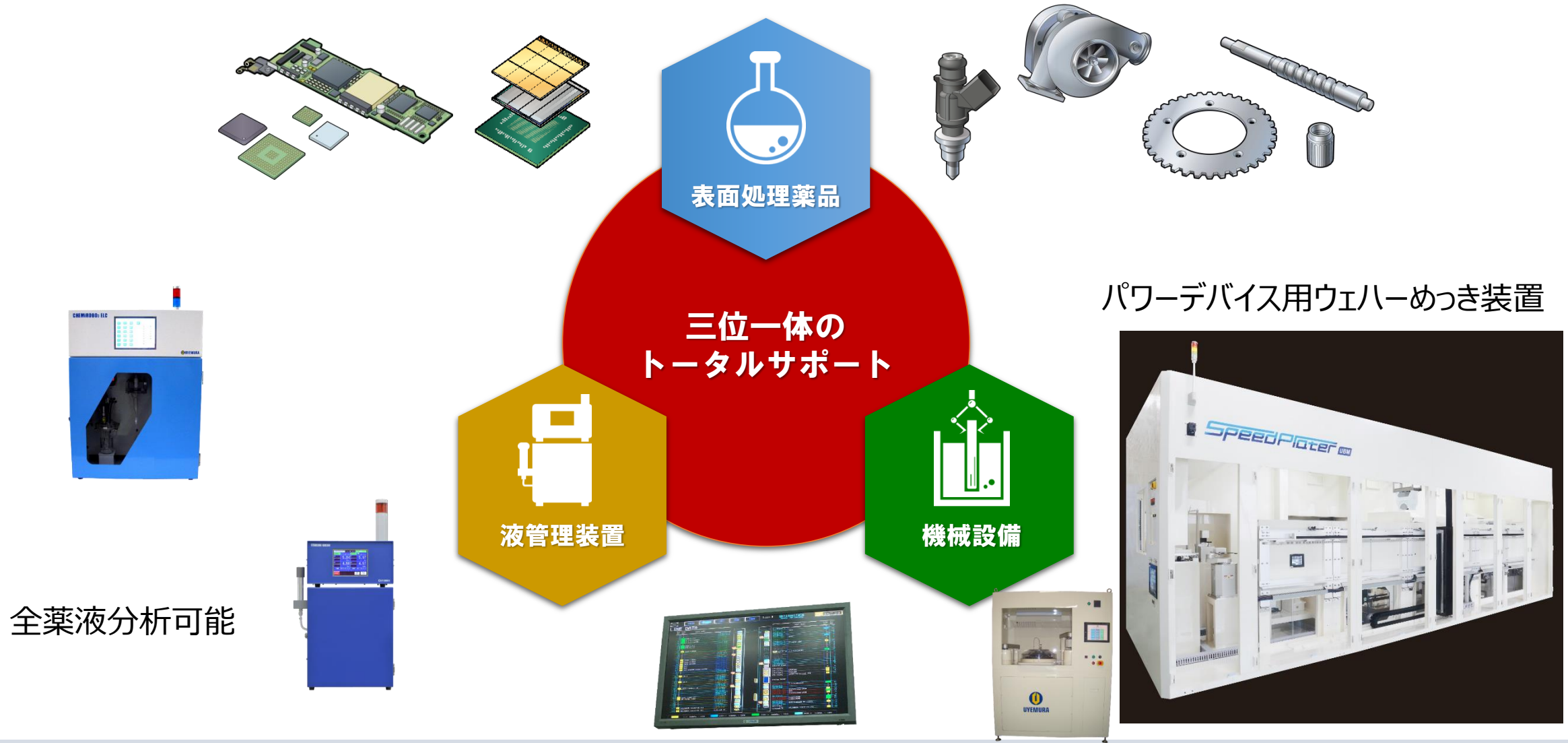
- ・所在地：上海市化学工業区F6-4地块上海国际化工新材料创新中心北河路17-10号
- ・投資額：約16,500千元（建物・分析機器等）
- ・クリーンルーム、実験室、分析室等完備

2024年4月15日業務開始

主要ビジネス状況

顧客満足度向上を目指す 誠心を以って実行に徹底する

- 市場占有率が高い市場では、更に市場占有率を高めるための営業および開発戦略
- 市場占有率が低い市場では、市場占有率を上げるための営業および開発戦略
- 市場の流れに合う製造戦略
- 薬品、機械および液管理装置のトータルソリューションの提供



➤ 現行市場状況

- ① 国内：PC関連はコロナ禍前に戻りつつあるが、未だサーバー関連は在庫調整により出荷が大きく減少した状態が継続
パワーデバイスは落ち率は低く比較的堅調
- ② 海外：国内とほぼ同じ傾向。車載も同様
 - * 半導体関連は在庫調整が終われば潜在的に需要は戻ると予想

➤ 現在注力している技術

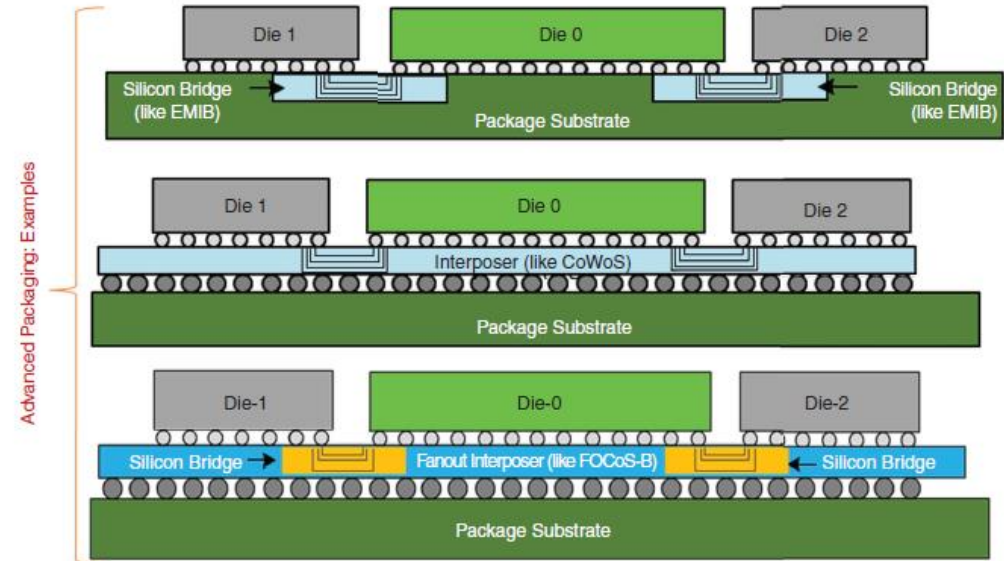
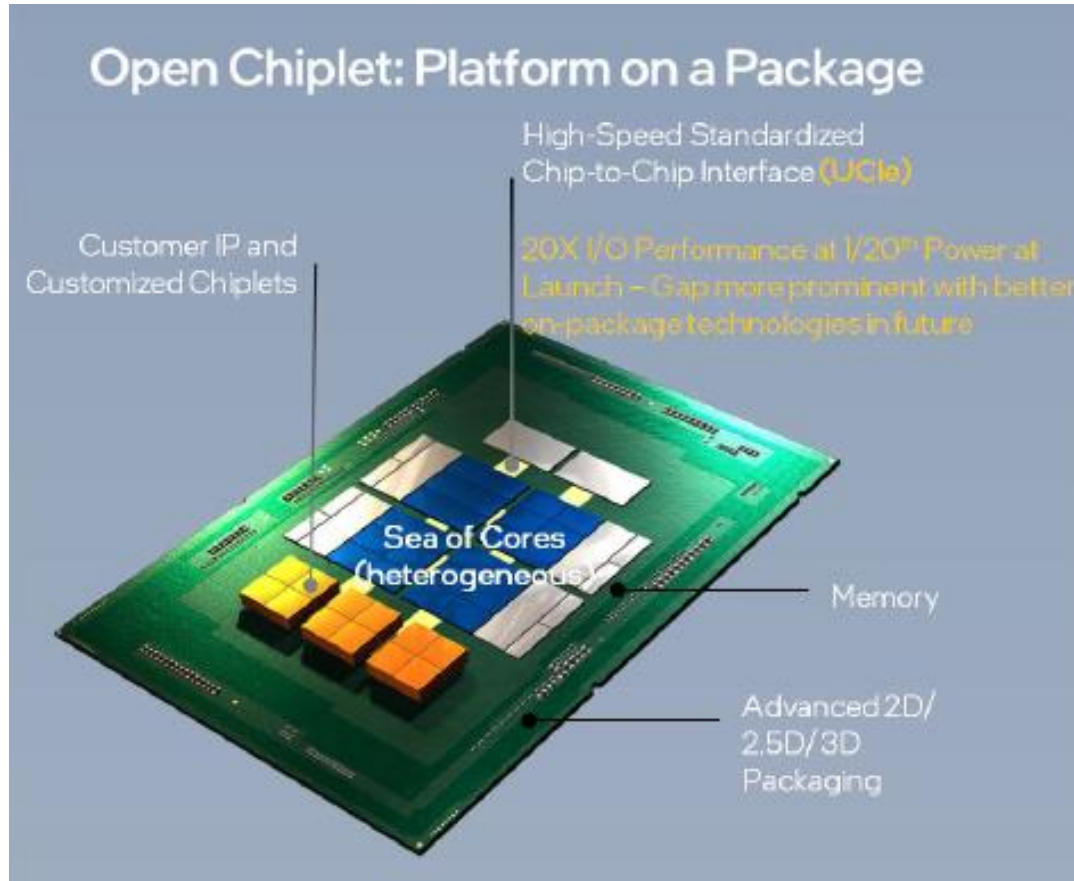
次世代パッケージ技術、通信向け基板技術、カーエレクトロニクス技術、環境関連技術

➤ 今後注力すべき技術

先端パッケージ向け配線技術およびバンプ接合技術

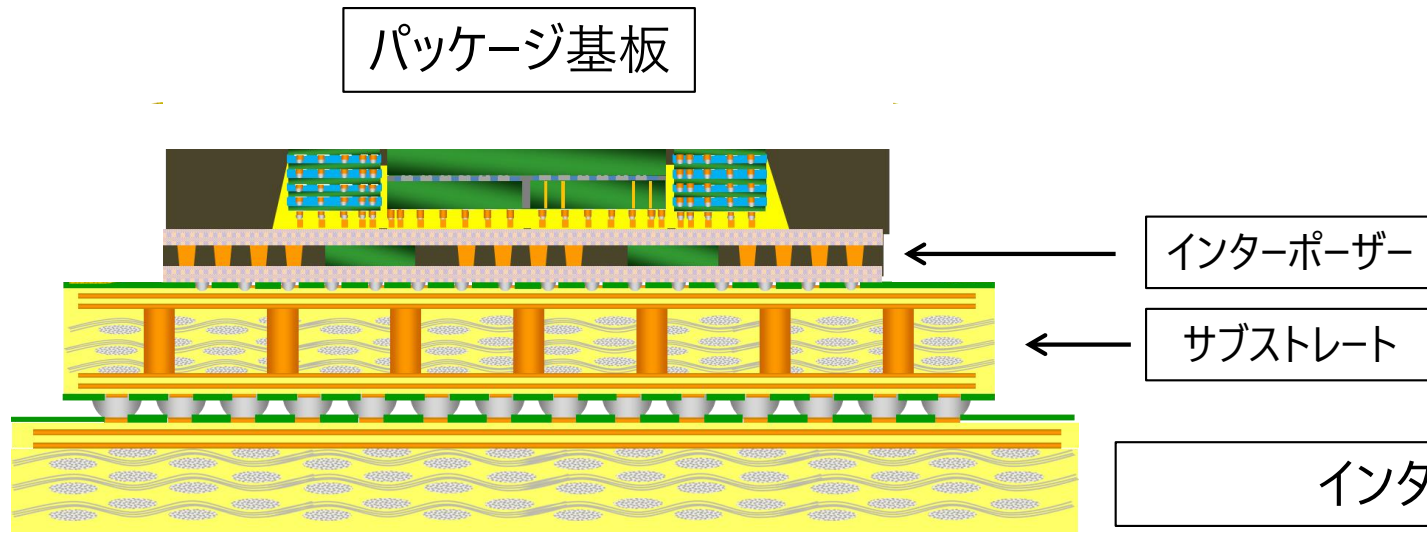
次世代接合材料向け表面処理技術、環境対応トータル技術開発

先端パッケージに求められる技術



- 1) 高信頼性基材の導入
- 2) 高信頼性接合技術の進歩
- 3) 消費電力削減への挑戦

Universal Chiplet Interconnect Express (UCIe): Building an open ecosystem, UCIe, March 2022



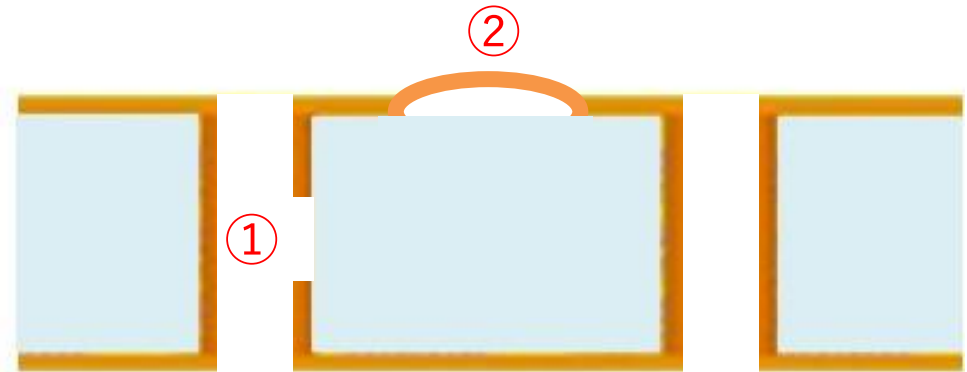
ガラス特性

- 高剛性
- 低熱膨張係数
- 高平滑性

要求特性

- ⇒ ねじれ寸法精度
- ⇒ 反り寸法精度
- ⇒ 微細配線形成

インターポザーやサブストレートにガラス採用



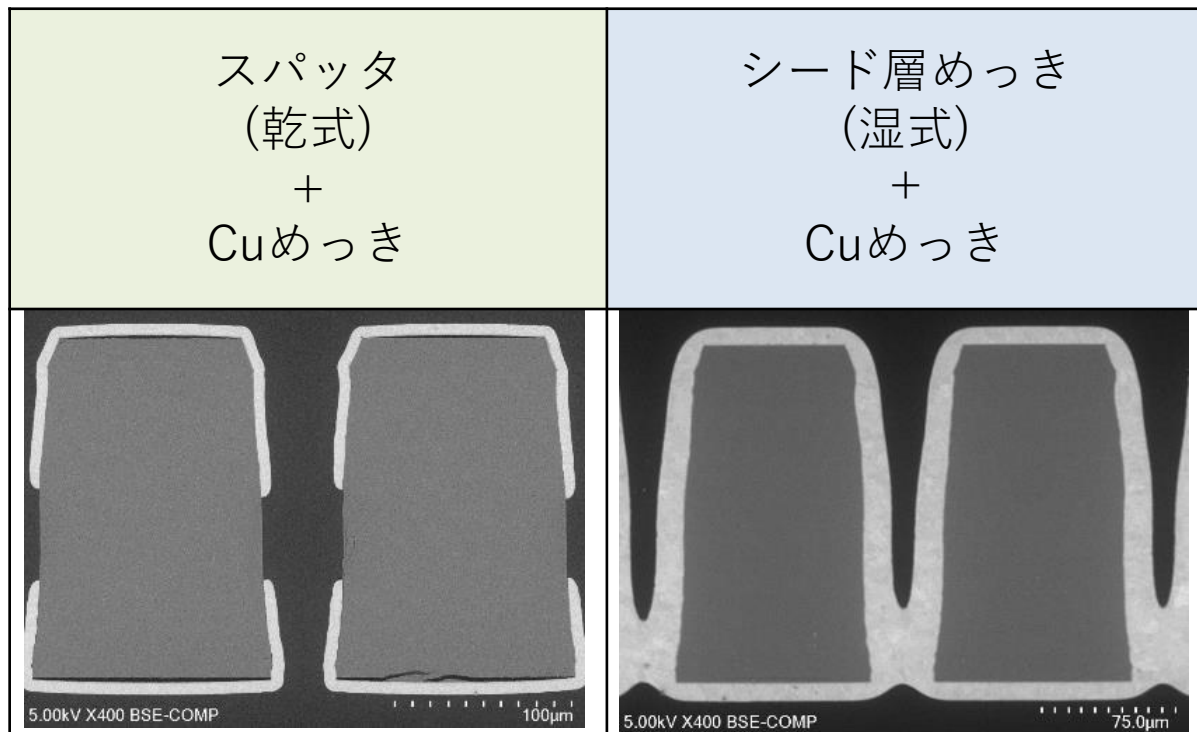
スルホール付きガラス基板

懸念事項

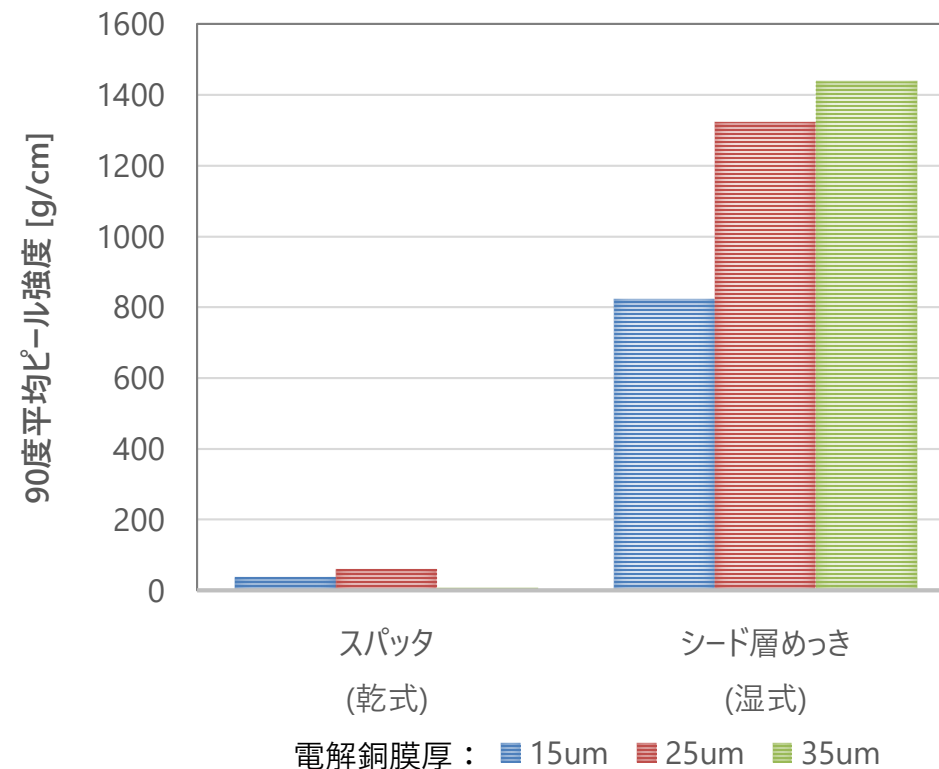
- ① スルホール内断線
- ② 配線密着性

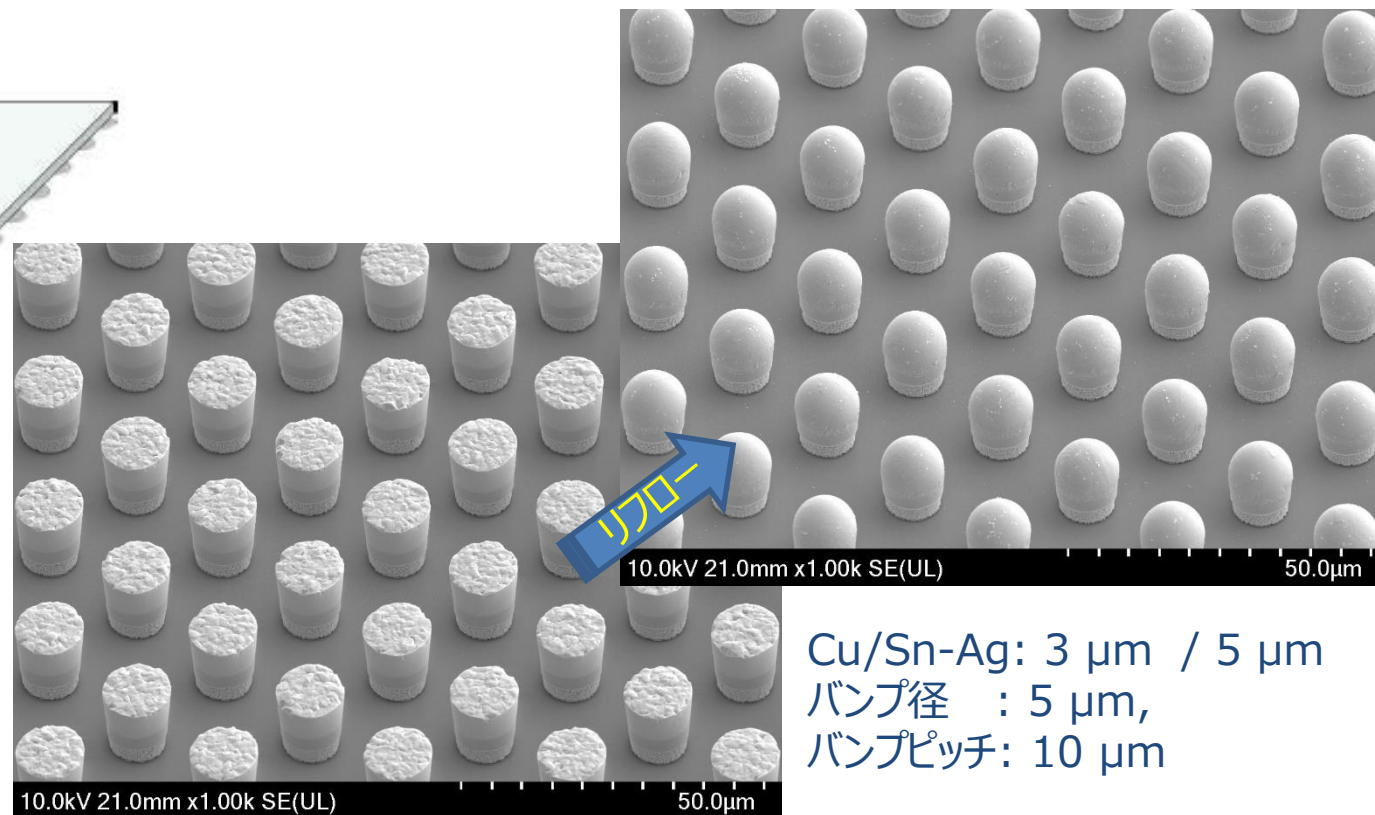
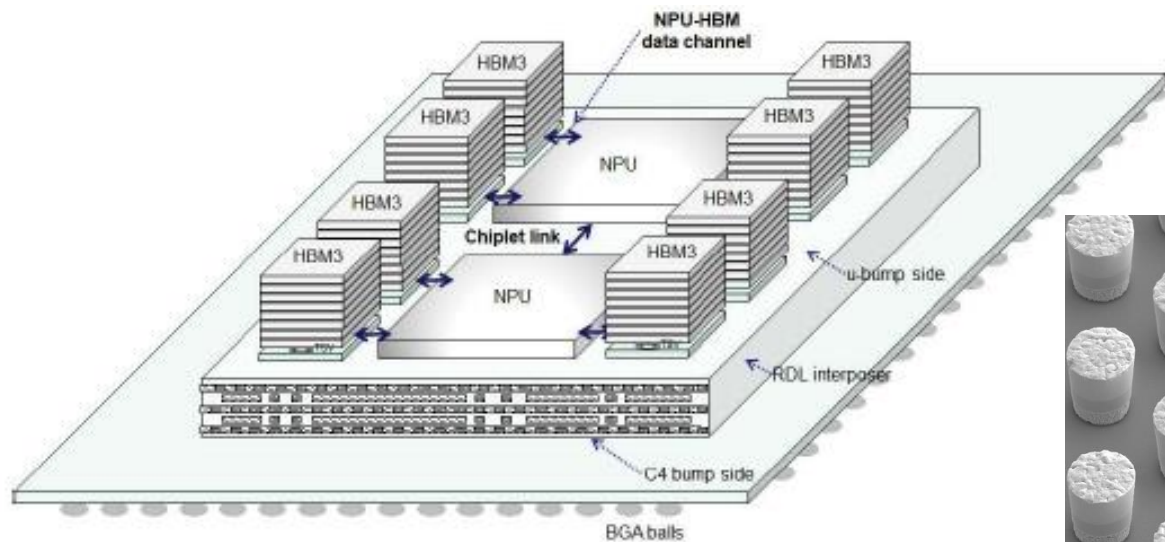


スルホール内断線



配線密着性



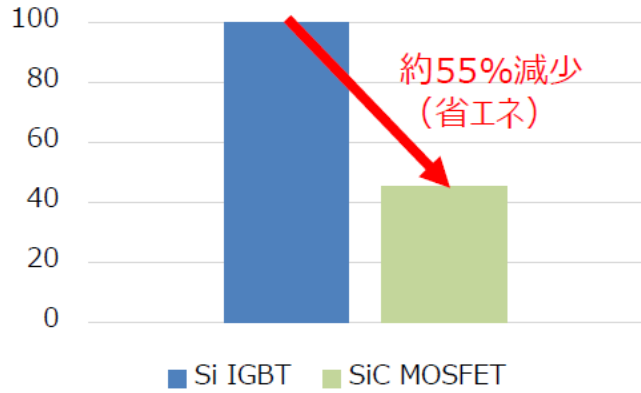


Chiplet Heterogeneous-Integration AI Processor,
 International conference on Electronics, Information
 and Communication (ICEIC), February 2023

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 (NEDO)
 「ポスト 5 G 情報通信システム基盤強化研究 開発事業」(JPNP20017)

次世代パワー半導体に求められる技術

<Si/SiCパワー半導体のエネルギー損失>

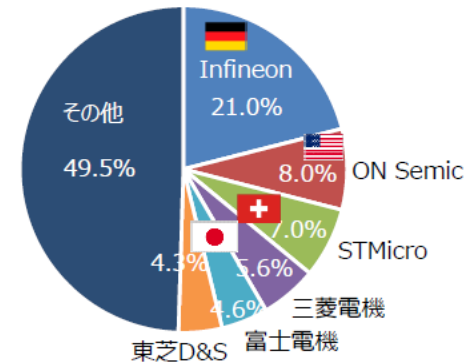


※用途は、鉄道車両用インバーターを想定
 ※縦軸（エネルギー損失）は、Siパワー半導体を100とした場合の値

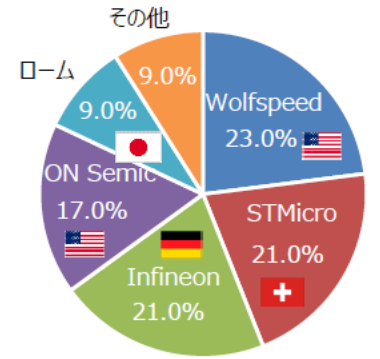
SiCパワー半導体の市場推移



Siパワー半導体のシェア



SiCパワー半導体のシェア



半導体・デジタル産業戦略の現状と今後, 経済産業省, 令和5年11月29日

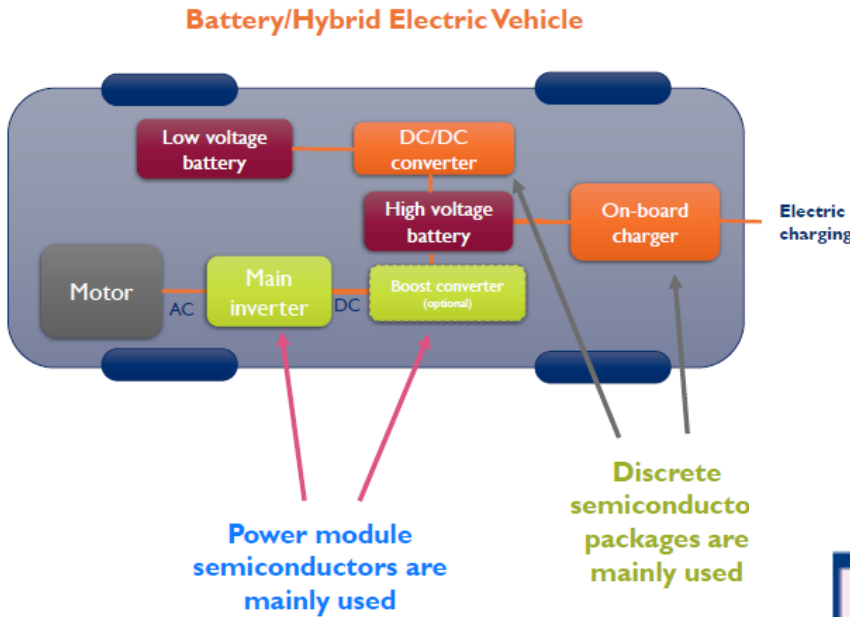
< SiCの特性 >

- 1) 電力損失の低減
- 2) 高い動作温度
- 3) 高速スイッチング動作
- 4) 高い放熱効果

高い動作温度へ適応した材料

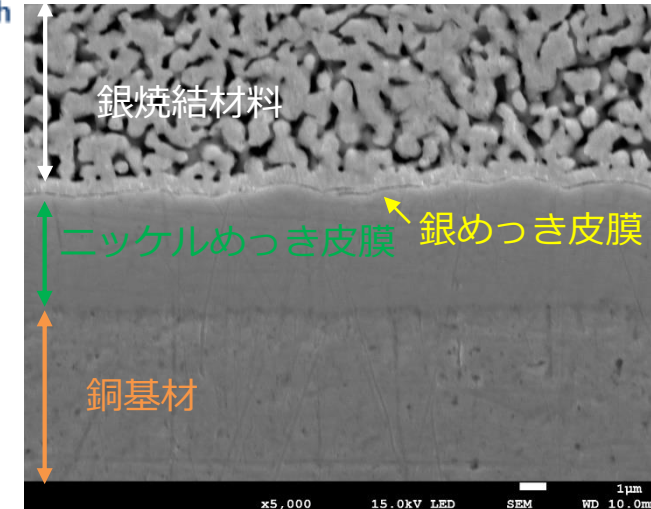
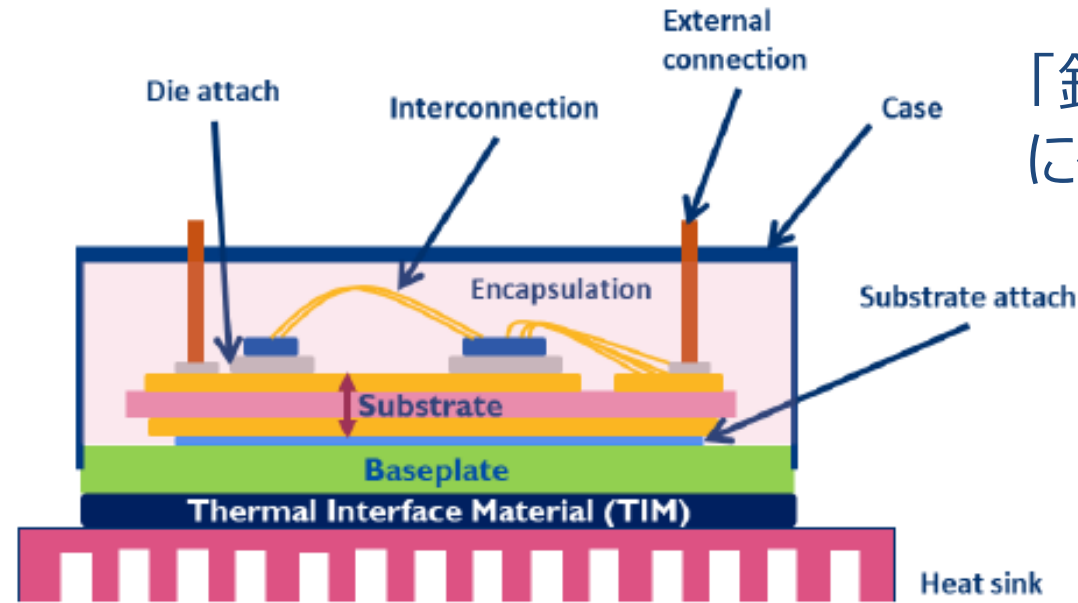
→ 焼結材料、封止材料、表面処理、等

新規接合材料（銀焼結、銅焼結）へ適したプロセスの提案



耐熱クラック性に優れた
Ni-P皮膜形成

「銀」焼結材料への接合性に優れた「銀」皮膜形成



Status of the Power Module Packaging Industry 2021-Market and Technology Report, Yole development, November 2021

ESG・SDGsに関する取り組み

当社は「Growing together with  (:You)」のグループ共通スローガンのもと、ステークホルダーの皆様と共に成長・発展し、社会に貢献できる企業を目指しています

Environment (環境)

環境対応型製品・技術の開発・拡販



社会発展・環境改善へとつながる製品の開発・提供



廃棄物・水使用量の削減



クリーンエネルギーの使用、電力使用量の削減



持続可能な
社会の実現

Social (社会)

社会貢献・地域貢献活動の推進



受注から出荷までの工程の自動化

いきいきと働ける職場環境の整備

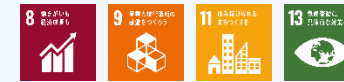


Governance (ガバナンス)

コンプライアンスの徹底、人権の尊重



BCP (事業継続計画) の実施



詳細な取り組み内容については、当社ホームページをご確認ください

1. Pbフリーめっき浴

- ・無電解Niめっき浴。主に汎用浴向け。
- ・Pbフリーの電気Snめっき浴。純Sn、Sn-Ag浴など。電子部品向け。

2. シアンフリー浴

- ・シアンフリー & フリーシアン補給不要の無電解Auめっき浴。ウェハー、電子部品向け。

3. デスマリアフリープロセス

- ・危険な過マンガン酸をつかわない基板向けプロセス。

4. ホルマリンフリー浴およびホルマリン不使用プロセス

- ・ホルマリンフリー無電解Cu浴の開発。ウェハー向け。

5. PFOS, PFOAフリー浴

- ・PTFE複合めっき。主に車載部品向け。

6. 廃液処理

- ・めっき液リサイクルユニット

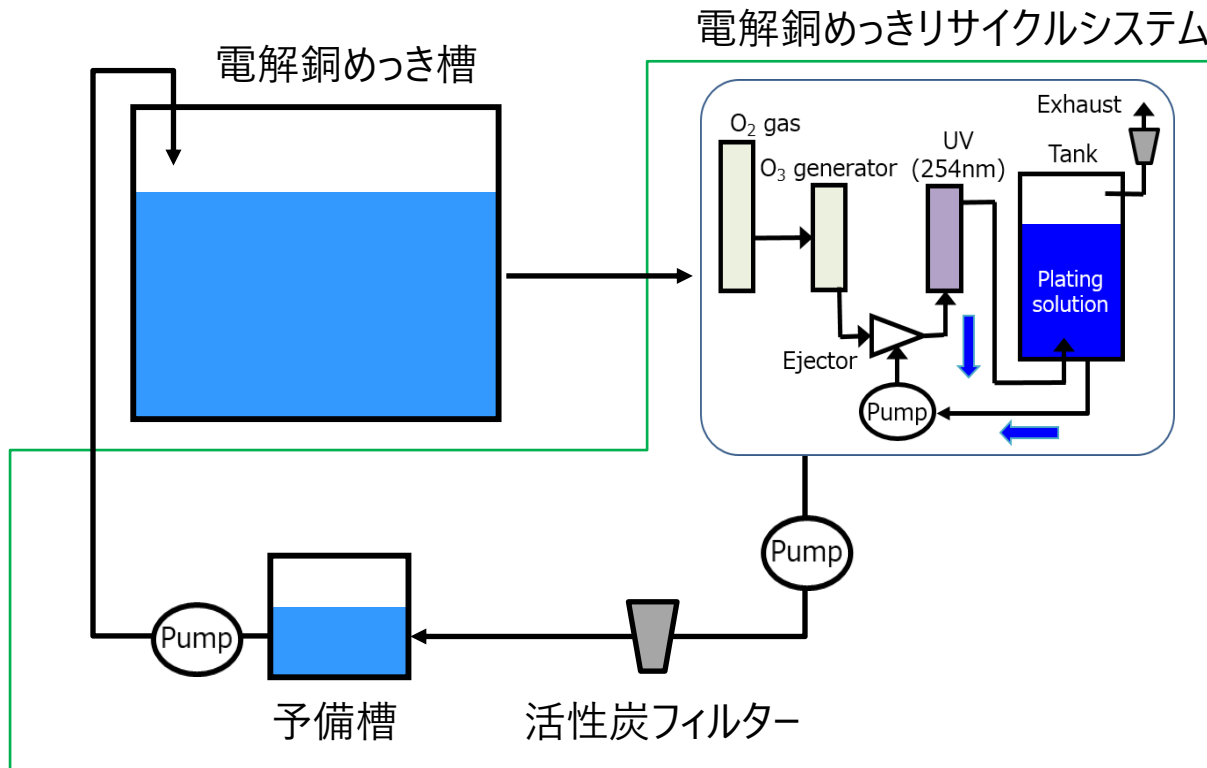
7. CO₂削減

- ・低融点接合材料めっき、低融点接合に適した最終表面処理





電解銅めっき リサイクルシステムイメージ



< 従来 >

電解銅めっき液は老廃物蓄積に伴い、一定期間使用後に全量廃液

< 新規提案 >

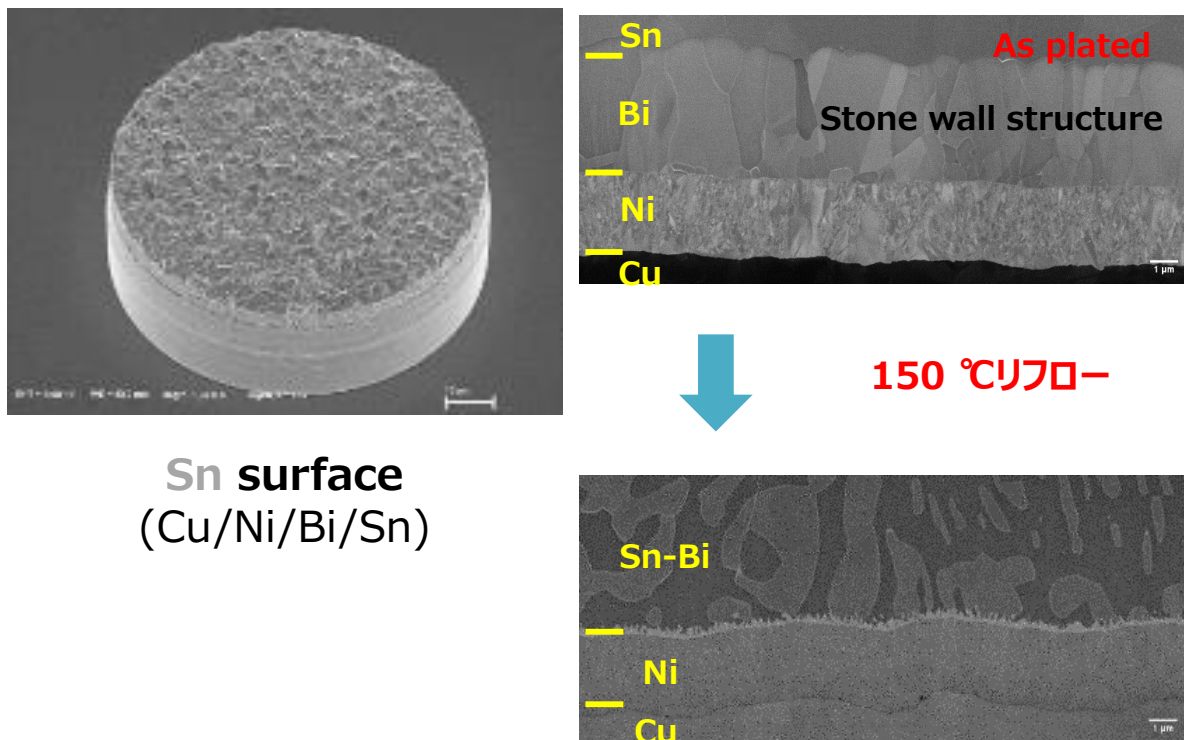
めっき液の一部を再生システムによって老廃物を分解除去することで、めっき液全体の性能を一定に保持

→半永久的なめっき液寿命



低融点 → 省電力 → CO₂削減

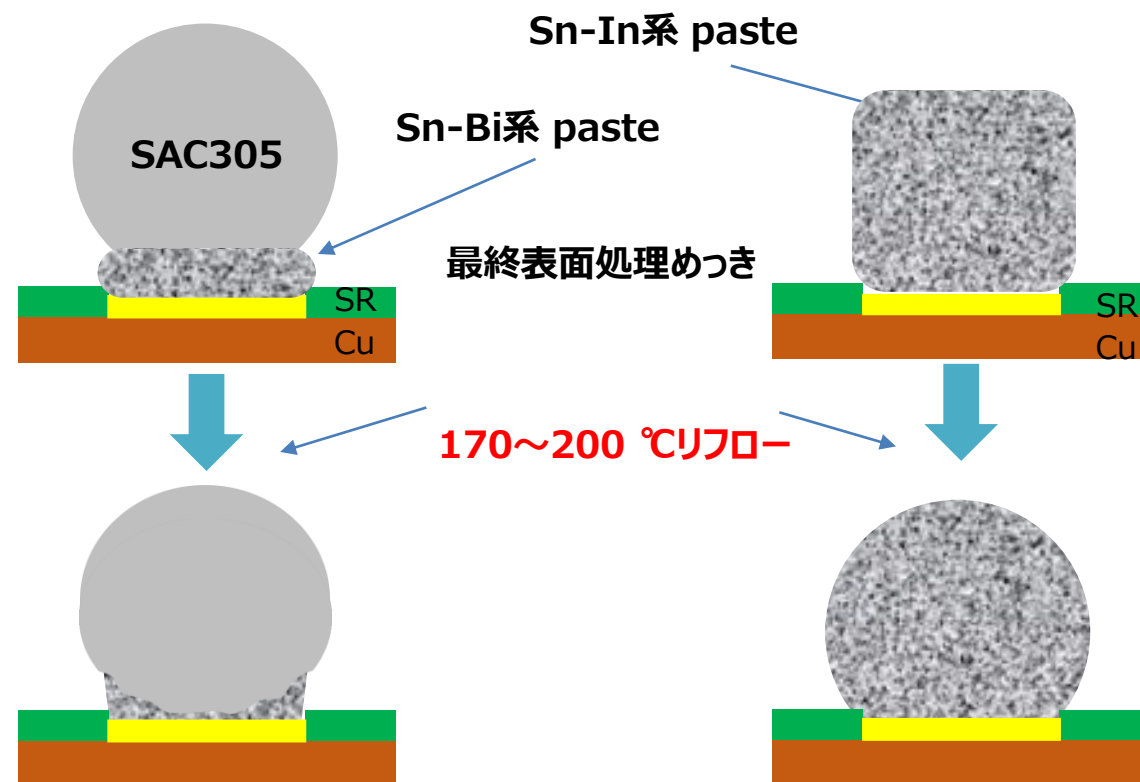
1) 低融点はんだ材料のバンプめっき

































Sn surface
(Cu/Ni/Bi/Sn)

Solder/solder joint for low temperature reflow by multi plating method, Wafer-level Packaging Symposium, January 2023

2) 低融点はんだ材料に適した最終表面処理の検討



グループ会社一覧

会社名	設立年	所在地	主な事業内容
上村工業株式会社	1848年(創業) 1933年(設立)	日本	    
ウエムラ・インターナショナル・コーポレーション	1985年	米国	  
上村(香港)有限公司	1986年	中国 (香港)	
台湾上村股份有限公司	1987年	台湾	    
サムハイテックス	1987年	タイ	   
上村工業(深圳)有限公司	1988年	中国 (深圳)	   
ウエムラ・インターナショナル・シンガポール	1992年	シンガポール	
ウエムラ・マレーシア	1996年	マレーシア	 
上村化学(上海)有限公司	2002年	中国 (上海)	
韓国上村株式会社	2010年	韓国	 
ウエムラ・インドネシア	2012年	インドネシア	 



営業



研究開発



薬品製造



機械製造



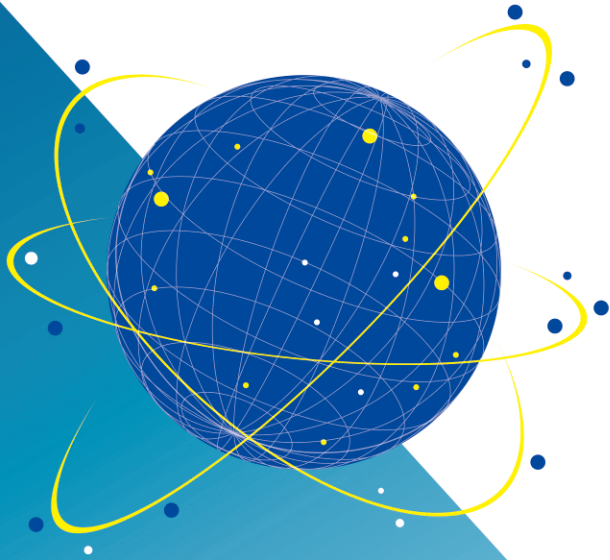
めっき加工



不動産賃貸

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

Growing together with



Uyemura Group Companies

- | | | | |
|-------------|---|-------------|---|
| ● Japan | C.Uyemura & Co., Ltd. | ● Taiwan | Taiwan Uyemura Co., Ltd. |
| ● USA | Uyemura International Corporation | ● Korea | Uyemura Korea Co., Ltd. |
| ● Hong Kong | Uyemura International (Hong Kong) Co., Ltd. | ● Singapore | Uyemura International (Singapore) Pte Ltd |
| ● Shenzhen | Uyemura (Shenzhen) Co., Ltd. | ● Malaysia | Uyemura (Malaysia) Sdn. Bhd. |
| ● Shanghai | Uyemura (Shanghai) Co., Ltd. | ● Thailand | Sum Hitechs Co., Ltd. |
| | | ● Indonesia | PT. Uyemura Indonesia |